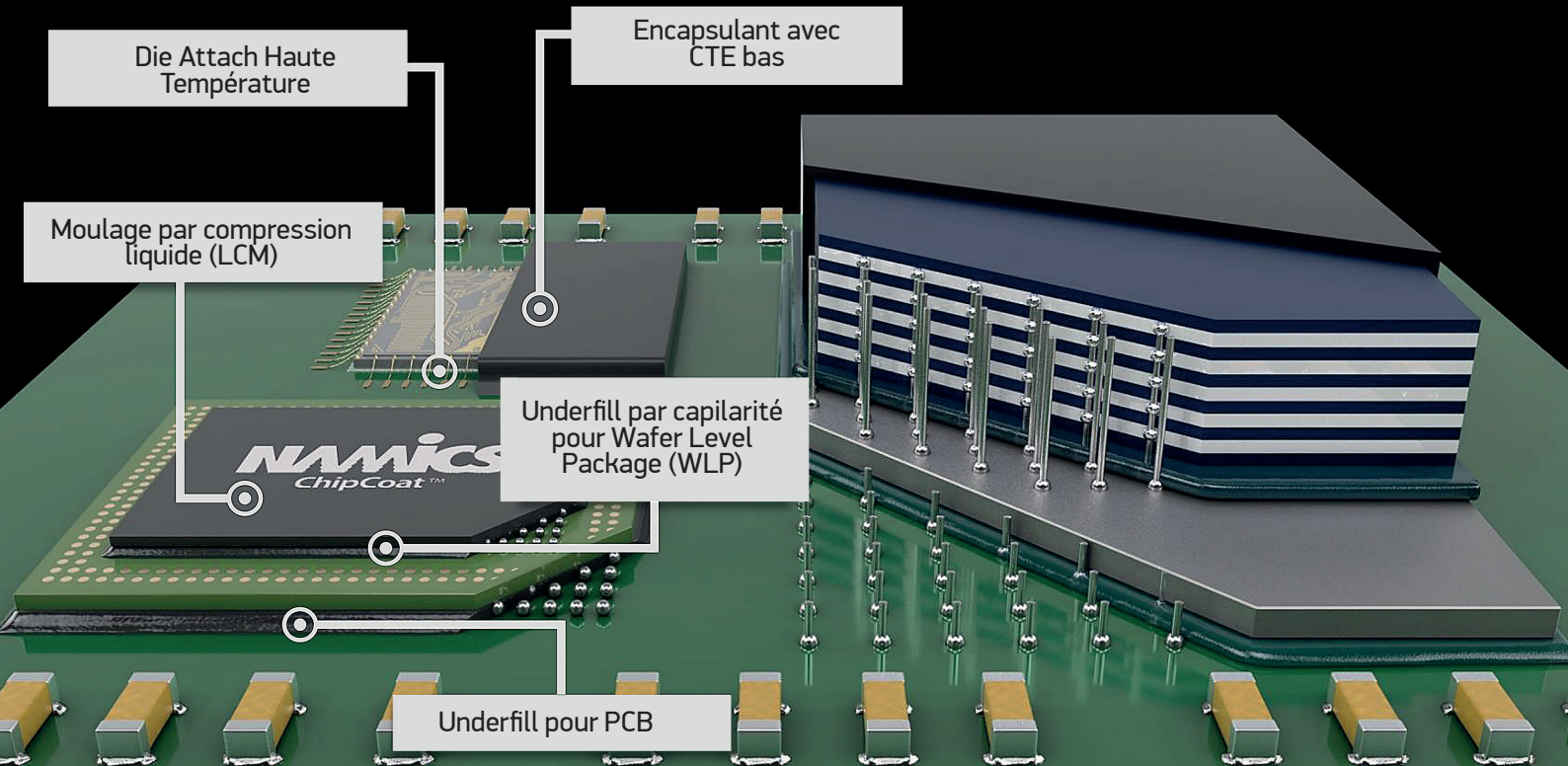


## SYSTEM IN PACKAGING (SIP)



### Faible facteur de forme, conception flexible, faible consommation d'énergie

La demande pour le packaging des semi-conducteurs d'aujourd'hui pousse vers l'intégration hétérogène de différents dispositifs et technologies. L'objectif est que les modules de nouvelle génération offrent des performances améliorées avec une consommation d'énergie plus faible tout en allant vers plus de miniaturisation. La technologie System in Package (SIP) permet l'intégration de capteurs et de différents modules dans un seul boîtier compact. Un boîtier SIP aura besoin de solutions avancées pour gérer:

Augmentation de la  
dissipation thermique

Protection contre les  
interférences RF

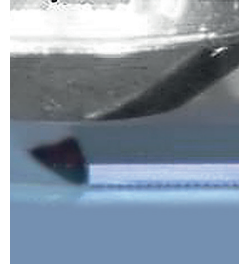
Faible facteur  
de forme

Haute fiabilité pour répondre aux  
futurs applications automobiles

NAMICS offre une gamme diversifiée de solutions novatrices pour relever ces défis liés aux boîtiers à venir.

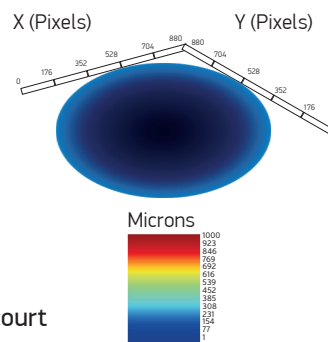
## ■ Underfill par capillarité pour les wafer level packages (WLP)

- Système de remplissage ultra-fin optimisé pour un remplissage sans vide sur les applications avec pilier Cu à faible espace
- Ecoulement minimal de résine dans la zone d'exclusion (KOZ)
- Formulé pour une productivité élevée et une grande fiabilité



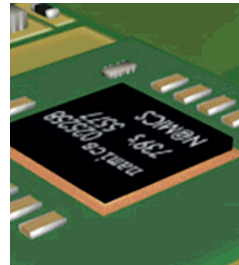
## ■ Moulage par compression liquide (LCM)

- Haute fiabilité et déformation minimale après la polymérisation post-moulage
- Système de remplissage optimisé dans les espaces réduits et sans trace d'écoulement
- Productivité élevée grâce au temps de polymérisation court
- Compatibilité de packaging au niveau du wafer ou de la carte



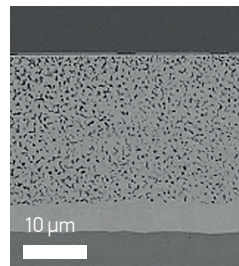
## ■ Underfill au niveau de la carte

- Conçu pour répondre aux exigences écologiques strictes de l'automobile
- Système Snap Cure à écoulement rapide pour remplir rapidement les puces de grandes tailles
- Retouche disponible avec une excellente fiabilité



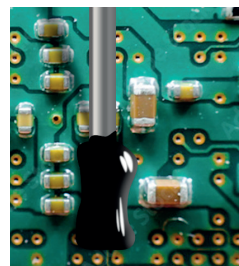
## ■ Die attach haute température

- Technologie de frittage sans pression et à basse température
- Performances thermiques et électriques inégalées
- Éprouvé et prêt pour la fabrication à grand volume
- Fiabilité inégalée de la technologie par résine renforcée et à faible module



## ■ Encapsulant à faible CTE

- Fiabilité et protection contre l'humidité exceptionnelles
- Protection supérieure des composants sensibles
- Facilité d'utilisation avec une polymérisation rapide et un excellent flux



## Notre entreprise

NAMICS est un leader mondial de la technologie pour les matériaux d'encapsulation électroniques avec plus de 70 ans d'expérience et de savoir-faire.

Nous fabriquons plus que des produits : nous construisons des relations, et NAMICS est l'étalon-or du service client en proposant des solutions dédiées et un service après vente de première classe afin de trouver une solution à votre propre application. Travaillons ensemble afin de découvrir comment NAMICS peut vous permettre d'atteindre vos objectifs.

## Contact

Hilpert electronics AG  
Täferenstrasse 29  
CH-5405 Baden-Dättwil  
Téléphone: +41 56 483 25 25  
Fax: +41 56 483 25 20  
office@hilpert.ch  
www.hilpert.ch

Pour en savoir plus:

